

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011年3月10日(10.03.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/027673 A1

- (51) 国際特許分類:
C11D 7/26 (2006.01) C11D 7/32 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01) C23G 5/036 (2006.01)
C11D 7/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/064088
- (22) 国際出願日: 2010年8月20日(20.08.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-203862 2009年9月3日(03.09.2009) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 荒川化学工業株式会社(ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒5410046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目3番7号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 田中 俊(TANAKA, Takashi) [JP/JP]; 〒5380053 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号 荒川化学工業株式会社研究所内 Osaka (JP). 田中 啓太(TANAKA, Keita) [JP/JP]; 〒5380053 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号 荒川化学工業株式会社研究所内 Osaka (JP). 守能 祥信(MORINO, Yoshinobu) [JP/JP]; 〒5380053 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号 荒川化学工業株式会社研究所内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人三枝国際特許事務所(Saegusa & Partners); 〒5410045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 北浜T N Kビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告(条約第21条(3))



WO 2011/027673 A1

(54) Title: CLEANING AGENT FOR REMOVAL OF, REMOVAL METHOD FOR, AND CLEANING METHOD FOR WATER-SOLUBLE, LEAD-FREE SOLDER FLUX

(54) 発明の名称: 鉛フリーハンダ水溶性フラックス除去用洗浄剤、除去方法及び洗浄方法

(57) Abstract: Disclosed is a cleaning agent for the removal of a water-soluble, lead-free solder flux that is capable of cleaning water-soluble flux residue, which is produced when soldering a lead-free solder with a water-soluble flux, in a short period of time, and that is provided with a superior solubility and ability to clean tight crevices. The cleaning agent for the removal of water-soluble, lead-free solder flux comprises in the range of 5 to 100 parts by weight of a glycol ether compound (A) per 100 parts by weight of water.

(57) 要約: 鉛フリーハンダを水溶性フラックスでハンダ付けする際に生ずる水溶性フラックス残渣を短時間で洗浄することができ、さらに優れた溶解性及び狭隙間洗浄性を有する鉛フリーハンダ水溶性フラックス除去用洗浄剤を提供することを目的とする。本発明は、水100重量部に対して、グリコールエーテル化合物(A)を5~100重量部含む鉛フリーハンダ水溶性フラックス除去用洗浄剤である。